精选快讯　硬件快讯　2026年11月17日 20:57

大族数控披露高精微针测试机已批量交付，可测1.6T光模块BGA Pitch≤150μm

要点

- 大族数控发布投资者关系活动记录表，披露其在AI服务器PCB及800G/1.6T高速光模块类载板领域的设备进展。
- 在钻孔与成型工艺方面，大族数控冷激光钻孔方案可稳定加工50μm密集微孔；
- 此外，大族数控LDI产品可将线路极差管控在3μm以内，满足±7%以内的严苛阻抗控制要求。

大族数控发布投资者关系活动记录表，披露其在AI服务器PCB及800G/1.6T高速光模块类载板领域的设备进展。公司高精微针测试机已实现1.6T光模块BGA Pitch≤150μm的超高精度测试，相关产品已通过下游头部客户验证并批量交付。

在钻孔与成型工艺方面，大族数控冷激光钻孔方案可稳定加工50μm密集微孔；高精度CCD对位六轴成型机量产精度达±25μm。其大扭力主轴机械通孔方案与优化升级的3D背钻方案已在客户端广泛应用，可实现31.5:1高厚径比通孔及0-4mil高精度背钻（CPK＞1.33）的量产加工。

此外，大族数控LDI产品可将线路极差管控在3μm以内，满足±7%以内的严苛阻抗控制要求。公司表示已与全球头部算力供应链客户开展联合研发，相关定制化设备已获得正式订单。

报道来源：guandian

来源网站：https://www.inews.today/